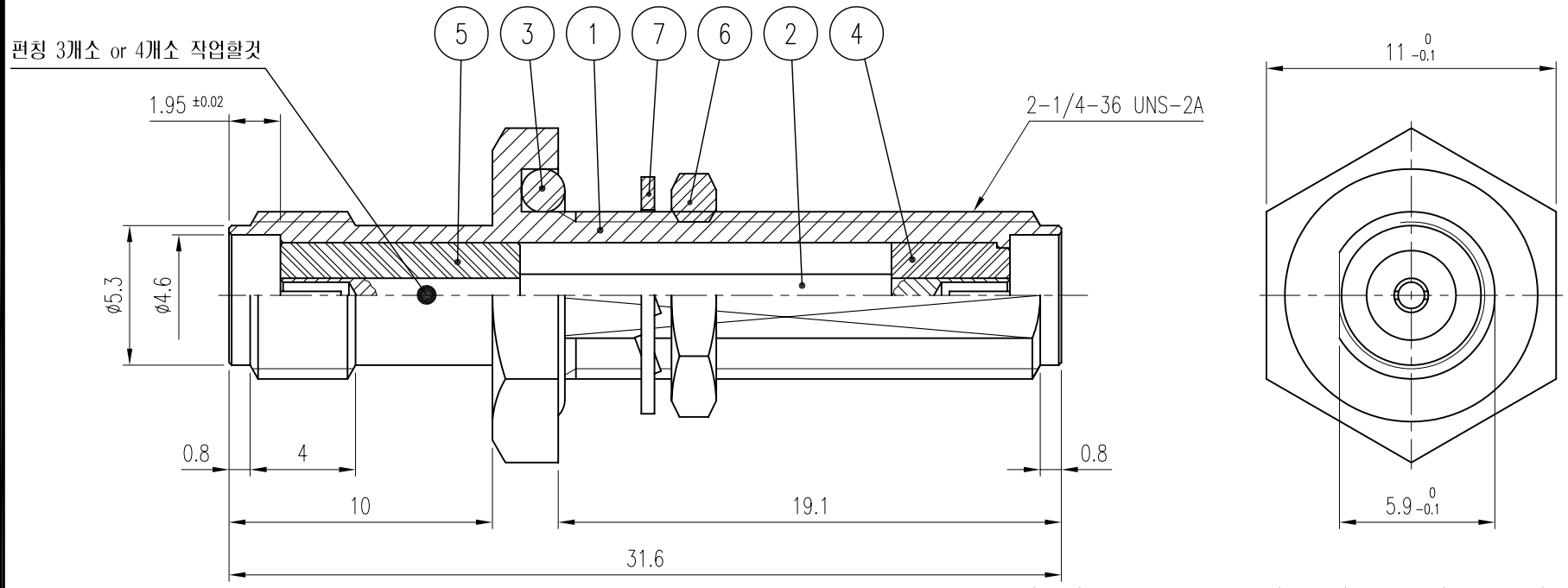
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	WASHER	1	SUS	부동태 처리	DWA00092-N/1 (Q2005)
6	NUT	1	SUS	부동태 처리	DNT00065-5/1 (N2004)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00162-N/1 (H2274)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00216-N/1 (H2261)
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00023-N/1 (G2004)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate 0.3μm	DAC00139-5/1 (E2472)
1	BODY	1	SUS	부동태 처리	DAD00139-5/1 (D2447)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일	2005. 11. 3.		
승인			
검도			
제도			
작성부서	연 구 소		
척도 4/1	단위 mm	중량 ___	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-BA-JJ VER.0

A4

도번 AD00286-7/1

K314-700-010